【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和6年8月22日(2024.8.22)

【国際公開番号】WO2023/112667
【出願番号】特願2023-567662(P2023-567662)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｃ　1/142(2006.01)
Ｈ０１Ｃ　7/00(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｃ　1/142
Ｈ０１Ｃ　7/00　１１０

【手続補正書】
【提出日】令和6年6月5日(2024.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板と、
前記基板上に形成された素子部と、
前記素子部に接続された引き出し電極と、
前記素子部と、前記引き出し電極の一部と、を覆う絶縁保護層と、
前記絶縁保護層の一部と、前記絶縁保護層に覆われていない部分の前記引き出し電極の表面と、を覆う中間電極と、
前記中間電極を覆う外部電極と、を備え、
前記中間電極は、導電粒子と、樹脂分と、を含み、
前記導電粒子は、繊維状導電粒子と、フレーク状導電粒子と、を含む、
電子部品。
【請求項２】
前記中間電極におけるカーボン粒子の含有率は、１ｗｔ％未満である、
請求項１に記載の電子部品。
【請求項３】
前記中間電極における前記繊維状導電粒子と前記フレーク状導電粒子の重量比は、５／５～７／３である、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項４】
前記中間電極の固形分中の前記導電粒子の重量が、４６ｗｔ％以上６１ｗｔ％以下である、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項５】
前記樹脂分は、多官能エポキシ樹脂と、エポキシ硬化剤と、を含有する、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項６】
前記繊維状導電粒子は、繊維状無機物を金属で覆った粒子を含む、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項７】

前記繊維状導電粒子は、平均繊維径が０．１μｍ以上２μｍ以下、平均繊維長が５μｍ以上３０μｍ以下、アスペクト比が５以上２００以下である、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項８】
前記フレーク状導電粒子は、薄片状金属粉を含む、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項９】
前記フレーク状導電粒子は、平均粒径が１μｍ以上３０μｍ以下であり、厚みと平均粒径のアスペクト比は、５以上３００以下である、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項１０】
前記中間電極は、カーボン粒子を実質的に含まない、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項１１】
前記絶縁保護層は、前記素子部を覆うガラス被膜と、前記ガラス被膜を覆う樹脂層と、を有する、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項１２】
前記外部電極は、電極層と、前記電極層を覆う金属めっき層と、を有し、
前記電極層は、樹脂分とカーボン粒子と銀粉を含む導体、又は金属スパッタにより形成される導体である、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項１３】
前記外部電極は、前記絶縁保護層の一部を覆う、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項１４】
前記引き出し電極は、銀を含む、
請求項１又は２に記載の電子部品。
【請求項１５】
前記導電粒子は、銀を含む、
請求項１又は２のいずれか１項に記載の電子部品。